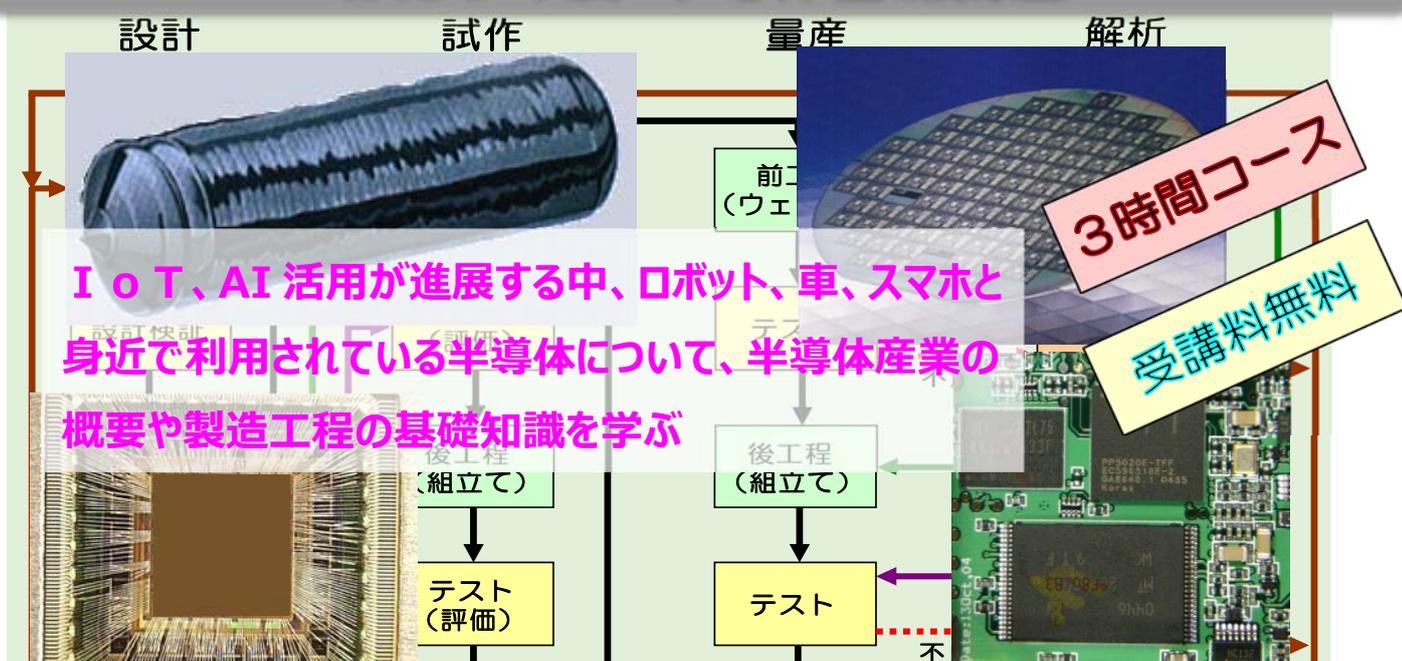


# 令和3年度 半導体基礎講座



**内容** 半導体産業の概要、および半導体製品の開発から製造、テストにいたるまでの工程概要と要素技術

**Web 配信** ① 2021年7月14日(水) 時間 13:30 ~ 16:30  
② 2021年7月21日(水) 時間 13:30 ~ 16:30  
③ 2021年7月28日(水) 時間 13:30 ~ 16:30

※1. 申込期限 2021年7月7日(水)

※2. 1回のみでの参加も可能です。

本年度は「ZOOM」を使用したweb配信のみとさせていただきます。  
参加案内 (URL) は後日申込者へメールでご連絡いたします。

**講師** 大野 武雄氏 (大分大学 理工学部 准教授)  
筒井 信明氏 (半導体人材育成教育コンサルタント)

**受講対象者** LSI クラスタ会員企業の方 (技術・事務を問いません)、  
または会員企業に就職予定の方

## 講座のねらい・特徴

半導体産業・動向から半導体製造工程やテストについての基礎知識・要素プロセス技術を短期間に学べる。

半導体産業・製造の基礎知識を学ぶことにより、今後従事する、または従事している職務のレベルアップや改善が図れる。

当講座は「雇用調整助成金 (中小企業緊急雇用安定助成金)」を利用している、もしくは利用予定の事業所が外部委託訓練として利用できる講座です。  
(制度の詳細は、最寄りのハローワークまでお問い合わせ下さい)

主催:



大分県 LSI クラスタ形成推進会

<http://www.oita-lsi.jp/>

# 令和3年度 半導体基礎講座（3時間コース）

半導体基礎講座① 7月14日（水） 講師：大野 武雄氏		
半導体分野の基礎知識 （半導体について）	半導体とは	半導体材料について 半導体チップの中身 LSIについて 各種トランジスタ
	半導体の歴史	トランジスタ、LSIの歴史 半導体市場について
半導体基礎講座② 7月21日（水） 講師：筒井 信明氏		
半導体開発・製造工程概論 （ウェハー製造）	LSI開発・製造の流れ	LSI開発・製造の全体フロー
	LSIの開発・設計	LSI開発の流れ 設計 フォトマスク
	シリコンウェハー	シリコンウェハーの製造 シリコンウェハー口径と平坦性の推移
	ウェハー処理工程	ウェハープロセス リソグラフィ工程 エッチング工程 洗浄工程 イオン注入工程 熱処理・成膜工程 配線および電極形成工程
半導体基礎講座③ 7月28日（水） 講師：筒井 信明氏		
半導体製造工程概論 （組み立て、テスト）	LSI開発・製造の流れ	LSI開発・製造の全体フロー
	組み立て工程	実装技術 パッケージタイプの変遷 パッケージング
	半導体評価・テスト・解析	評価・テスト・解析の役割 評価 テスト 解析

## 参加申込規定

- 申込書に必要事項をご記入のうえ、E-mailまたはFAXでお送りください。

## ご注意

- 出席者を確認しますので、zoomでは名前表示をフルネーム（漢字・ローマ字）にしてご参加ください。
- 録音、撮影（スクリーンショット）はご遠慮ください。
- **テキストは各社申込代表者のみに電子ファイルで送付いたします。**  
**代表者は受講者に配布をお願いいたします。**  
**(※1)開示は各社内のみとしてください。**  
**(※2)著作権法に基づき、本書の全てまたは一部を複写・複製・転載する事を一切禁止します。**
- 受講証明書は発行致しませんので、必要な方はお申し出ください。

## お問い合わせ&お申込先

FAX (0977)72-9968 / E-mail [et-course@elia-jp.com](mailto:et-course@elia-jp.com)  
 〒879-1507 大分県速見郡日出町大字豊岡字岩垣 799 番地 1 (株)エリア 日カ/小石 ☎0977-73-2485